低压下气流对激光沉积纳米硅晶化及尺寸的影响*

王英龙" 高建聪 褚立志 邓泽超 丁学成 梁伟华 傅广生

(河北大学物理科学与技术学院,保定 071002)

(2012年7月11日收到;2012年8月27日收到修改稿)

纳米硅具有明显的光致发光效应和量子尺寸效应, 广泛的应用在现代电子工业和太阳能光伏工业中. 尺寸影响着纳米硅的实际用途, 因此制备尺寸可控的纳米硅晶粒具有很重要的实际意义. 本文采用脉冲激光沉积 (PLD) 技术, 在烧蚀点水平方向、距靶 2 cm 处引入一束流量为 5 sccm 的氢 (Ar) 气流, 在 0.01—0.5 Pa 的 Ar 气压下烧蚀高阻抗 单晶硅 (Si) 靶. 在管口正下方 1 cm 处水平放置衬底来沉积纳米 Si 薄膜; 并用同一装置, 在 0.08 Pa 的 Ar 气压下分 别引入流量为 0, 2.5, 5, 7.5, 10 sccm 的 Ar 气流沉积纳米 Si 薄膜. 利用原子力显微镜 (AFM)、X 射线衍射 (XRD)、 Raman 散射对样品表面形貌和微观结构进行分析表征. 结果表明: 不引入气流时出现纳米 Si 晶粒的阈值气压是 0.1 Pa, 引入气流后出现纳米 Si 晶粒的阈值气压为 0.05 Pa. 晶粒尺寸随着气流流量的增大而减小.

关键词:脉冲激光烧蚀,纳米 Si 颗粒,尺寸,气流 PACS: 52.38.Mf, 61.46.Hk

1引言

纳米 Si 晶粒由于具有量子尺寸效应^[1]、光致 发光特性和电导输运特性 [2],在大规模光电集成领 域具有广阔的应用前景^[3],制备技术也随着科技的 发展日趋成熟^[4]. 在众多制备方法中^[5,6], 脉冲激 光烧蚀 (PLD) 技术因具有玷污小和生长速率快等 优点,引起了人们的广泛关注^[7,8].采用 PLD 法制 备薄膜的过程中,诸多工艺参数都会影响薄膜生长 的质量. 譬如, 环境气体种类和环境气压会影响薄 膜的结晶质量和纳米颗粒的大小^[9]. 2000年, Wu 等在氦气环境中加入一束 Ar 气流,在不同位置沉 积制备了尺寸不一的纳米 Si 颗粒,得出纳米 Si 颗 粒尺寸随着偏离羽辉轴向的夹角的增大而减小^[10]. 本课题组曾提出了成核区模型^[11],并在 10 Pa 的氦 气中引入一束氦气流的情况下确定了成核区的位 置^[12]. 然而此工作忽略了气流在烧蚀粒子形成纳 米 Si 晶粒中成核与生长的影响. 众所周知, 采用纳 秒激光沉积技术需在一定压强的环境气体氛围中

DOI: 10.7498/aps.62.025204

完成,而在真空或较低压强下无法直接制备得到纳 米晶粒^[13]. Wang 等在 10 Pa 的 Ar 气下不同位置引 入一束 30 sccm 的 Ar 气流^[14],得出了气流对纳米 Si 晶粒的尺寸有影响,但由于环境气压较高无法分 辨气流和环境气体对纳米 Si 晶粒尺寸的影响.本文 将在不同气压下引入一束 5 sccm 的 Ar 气流,并在 0.08 Pa 下引入不同流量的 Ar 气流沉积纳米 Si 薄 膜,与不引入气流做对比,研究环境气压与气流流 量对纳米 Si 成核与生长的影响.

2 实验方法

脉冲激光烧蚀装置如图 1 所示,由激光光源 和真空系统等构成.激光光源使用德国 Lambda Physik 公司生产的 XeCl 脉冲准分子激光器 (波长 为 308 nm,脉冲宽度为 15 ns),固定激光能量密度 为 3 J/cm²,脉冲频率为 3 Hz.真空反应室的真空度 达到 2×10⁻⁴ Pa 后,在烧蚀点右方 2 cm 的位置处 向下引入一束 Ar 气流 (管口直径为 2 mm),在管口 下方 1 cm 的位置上放置单晶 Si(111) 或玻璃衬底.

*国家重点基础研究发展计划(批准号: 2011CB612305)、河北省高等学校科学研究项目(批准号: Q2012084)和河北省自然科学基金(批准号: E2011201134, E2012201035)资助的课题.

© 2013 中国物理学会 Chinese Physical Society

http://wulixb.iphy.ac.cn

[†]通讯作者. E-mail: hdwangyl@hbu.edu.cn

首先控制气流流量为5 sccm的 Ar 气,在环境气压 为 0.01, 0.03, 0.05, 0.08, 0.1, 0.5 Pa 的 Ar 气压下激 光烧蚀电阻率为 3000 Ω·cm 的高纯度单晶 Si 靶, 沉 积一系列纳米 Si 薄膜. 然后适当降低气压, 同时确 保改变流量不影响气压大小,因此选择在 0.08 Pa, 气流流量分别为 0, 2.5, 5, 7.5, 10 sccm 的条件下沉 积纳米 Si 薄膜. 其中在单晶 Si 衬底上沉积时间为 3 min, 在玻璃衬底上的沉积时间为 4 h, 衬底保持为 室温. 使用美国 Instruments 公司生产的 Nanoscope IV 型原子力显微镜 (AFM) 测量样品的表面形貌, 以研究单晶 Si 衬底上沉积的纳米 Si 晶粒的平均尺 寸;采用日本理学公司生产的 Rigaku D/Max 型 X 射线衍射谱仪 (XRD 功率为 12 kW, Cu Kα 辐射作 为激发源, λ = 0.15418 nm) 和 MKI-2000 型 Raman 谱仪对玻璃衬底上的样品进行分析,以研究薄膜的 晶态成分.



图 1 激光烧蚀沉积装置图

3 实验结果及讨论

图 2 是在不同气压下沉积纳米 Si 薄膜的 XRD 谱, 从图中可以看出不引入气流时, 在 0.1 Pa 才出 现纳米 Si 晶粒对应的特征峰, 引入一束 5 sccm 的 Ar 气流后, 在 0.05 Pa 时出现了纳米 Si 晶粒的对应 的特征峰.结果表明不引入气流时出现纳米 Si 晶 粒的阈值气压是 0.1 Pa, 引入气流后出现纳米 Si 晶 粒的阈值气压是 0.05 Pa, 因此气流的引入能够在激 光烧蚀过程中环境气压相对较低的情况下形成纳 米 Si 晶粒.

图 3 是在 0.08 Pa 下引入不同流量的 Ar 气的 AFM 图, (a)—(e) 对应的流量分别为 0, 2.5, 5, 7.5, 10 sccm 制备的样品的 AFM 图. 经过统计得到 2.5, 5, 7.5, 10 sccm 的 Ar 气流对应的颗粒尺寸分别是

24.9, 23.6, 21.8, 20.0 nm. 由此可以得出随着气流流量的增大, 晶粒的尺寸逐渐减小.



图 2 不同气压下样品的 XRD 谱 (a) 不引入气流下样品的 XRD 谱; (b) 引入气下样品的 XRD 谱

对与 AFM 中相应的在玻璃衬底上沉积的样品 进行 Raman 和 XRD 测量,结果如图 4. 从图中可以 看出不加气流时 Raman 谱峰位于 480 cm⁻¹ 附近; 引入 2.5, 5, 7.5, 10 sccm 的 Ar 气流时 Raman 谱峰 分别位于 518.47, 518.00, 516.95, 516.45 cm⁻¹. 均偏 离了单晶 Si 的特征峰 (520 cm⁻¹). 且随着气流的 增大偏离的程度增大(见图 4(a) 插图). 根据晶粒尺 寸计算公式 $d = 2\pi (B/w)^{1/2}$ 可知偏离单晶 Si 峰越 大, 晶粒尺寸越小. 其中 d 是晶粒尺寸, B 为一常数 2 nm²/cm, w 为散射频移. 在 XRD 谱线中, 不引入 气流时在 28.5° 附近没有 Si(111) 特征峰, 引入 2.5, 5, 7.5, 10 sccm的 Ar 气流时均出现了 Si(111) 特征 峰,证明形成了纳米 Si 晶粒. 且随着气流流量的增 大,谱线衍射峰的半高宽逐渐增大,根据谢乐公式 $d = k\lambda/(\beta \cos \theta)$ 可知, 晶粒的尺寸逐渐减小, 式中 k 为一常数, λ 为 X 射线波长, β 为衍射峰的宽化. Raman 和 XRD 谱均表明了在引入气流时形成了纳 米 Si 晶粒,同时也证明了纳米 Si 晶粒的尺寸随着 引入气流流量的增大而减小.



图 3 不同流量下的 AFM 图 (a)--(e) 对应的流量分别为 0, 25, 5, 7.5, 10 sccm



图 4 (a), (b) 分别是不同流量下样品的 Raman 和 XRD 谱

不引入气流时,在低压环境中,烧蚀粒子在向 衬底传输的过程中与环境气体发生有效碰撞的次 数较少,烧蚀粒子在到达衬底之前一直维持着较高 的温度,难以凝聚成核.所以在低于 0.1 Pa 下制备 的样品呈非晶态.当环境气压增大到一定值,环境 气体和烧蚀粒子之间发生有效碰撞次数增多,烧蚀 粒子温度降低,从而凝聚成核.

在引入一束竖直向下的气流的情况下,由于气 流的密度远大于环境气体的密度,使得烧蚀粒子到 达气流所在位置时会受到气流中气体分子的碰撞 加剧,使得温度能够很快降低到成核所需要的温度, 从而凝聚成核,所以引入一束 Ar 气流后能在环境 气压更低的情况下形成纳米 Si 晶粒.

在 0.08 Pa 下引入不同流量的气流后,样品都 出现了纳米 Si 晶粒的对应峰. 且晶粒尺寸随着气 流的增大而减小. 气流的引入提高了纳米 Si 晶粒 的成核率和生长率. 而晶粒最终尺寸由成核率、生 长率和生长时间决定. 在竖直方向烧蚀粒子的初速 度很小, 烧蚀粒子与速度大的 Ar 原子碰撞后获得 的速度大, 即烧蚀粒子在气流流量大的情况下获得 的向下的速度大.速度大的烧蚀粒子到达衬底所需 的时间较短,即生长时间较短.所以,虽然晶粒的成 核率和生长率随着气流的增大而增大,但晶粒的生 长时间随着气流的增大而减小,因此晶粒尺寸会随 着气流的增大而减小.

4 结 论

采用脉冲激光烧蚀技术,研究了在低压环境中

- [1] Canham L T 1990 Appl. Phys. Lett. 57 1046
- [2] Zhu S W, Wang L, Chen X, Tu H L, Du J 2010 Chinese J. Lasers 37 882 (in Chinese) [朱世伟, 王磊, 陈兴, 屠海令, 杜军 2010 中国激光 37 882]
- [3] Song C, Chen G R, Xu J, Wang T, Sun H C, Liu Y, Li W, Chen K J 2009 Acta Phys. Sin. 58 7878 (in Chinese) [宋超, 陈谷然, 徐骏, 王涛, 孙红程, 刘宇, 李伟, 陈坤基 2009 物理学报 58 7878]
- [4] Liu Y S, Chen K, Qiao F, Huang X F, Han P G, Qian B, Ma Z Y, Li W, Xu J, Chen K J 2006 Acta Phys. Sin. 55 5404 (in Chinese) [刘艳松, 陈铠, 乔峰, 黄信凡, 韩培高, 钱波, 马忠元, 李伟, 徐骏, 陈坤基 2006 物理学报 55 5404]
- [5] Ratto F, Locatelli A, Fontana S, Kharrazi S, Kulkarni S K, Heun S, Rosei F 2006 Phys. Rev. Lett. 96 1031
- [6] Gao H, Liao L Z, Zhang Z H 2009 Acta Phys. Sin. 58 0427 (in Chinese) [高皓, 廖龙忠, 张朝晖 2009 物理学报 58 0427]
- [7] Nichols W T, Malyavanatham G, Hennke D E, Brock J R, Becker M F, Keto J W, Glicksman H D 2000 J. Nanopart Res. 2 141

- 气流对制备纳米 Si 晶粒成核及生长的作用. 得出 不引入气流时出现晶粒的阈值气压是 0.1 Pa, 引入 一束 5 sccm 的 Ar 气后出现晶粒的阈值气压是 0.05 Pa. 在 0.08 Pa 的 Ar 气环境中, 不引入气流时样品 呈非晶态, 引入 Ar 气后呈晶体, 且晶粒尺寸随着气 流流量的增大而减小. 从脉冲激光烧蚀动力学进行 了解释. 为制备尺寸可控的纳米 Si 晶粒提供了一 种新方法.
- [8] Nakata Y, Muramoto J, Okada T Maeda M 2002 J. Appl. Phys. 91 1640
- [9] Wang Y L, Zhang H S, Chu L Z, Ding X C, Fu G S 2008 J. Mater. Eng. 10 0248
- [10] Wu H P, Okano A, Takayanagi K 2000 Appl. Phys. A 71 643
- [11] Chu L Z, Lu L F, Wang Y L, Fu G S 2007 Acta Phys. Sin. 56 3374 (in Chinese) [褚立志, 卢丽芳, 王英龙, 傅广生 2007 物理学报 56 3374]
- [12] Deng Z C, Luo Q S, Ding X C, Chu L Z, Liang W H, Chen J Z, Fu G S, Wang Y L 2011 Chinese J. Lasers 38 145 (in Chinese) [邓泽超, 罗 青山, 丁学成, 褚立志, 梁伟华, 陈金忠, 傅广生 2011 中国激光 38 145]
- [13] Wang Y L, Deng Z C, Chu L Z, Fu G S, Peng Y C 2009 Euro. Phys. Lett. 86 15001
- [14] Wang Y L, Luo Q S, Deng Z C, Chu L Z, Ding X C, Liang W H, Chen C, Fu G S 2010 *High Power Laser and Particle Beams* 22 2199 (in Chinese)[王英龙, 罗青山, 邓泽超, 褚立志, 丁学成, 梁伟华, 陈超, 傅广生 2010 强激光与粒子束 22 2199]

Influence of gas flow on the size and crystal of silicon nanoparticle produced by laser deposition in low pressure*

Wang Ying-Long[†] Gao Jian-Cong Chu Li-Zhi Deng Ze-Chao Ding Xue-Cheng Liang Wei-Hua Fu Guang-Sheng

(College of Physics Science and Technology, Hebei Key Laboratory of Optic-electronic Information & Materials, Hebei University, Baoding, Hebei 071002,

China)

(Received 11 July 2012; revised manuscript received 27 August 2012)

Abstract

The nanocrystal silicon films were prepared by using a pulsed laser to ablate a high-resistivity single crystalline Si target in an ambient pressure range of 0.01–0.5 Pa of pure argon gas. An argon gas flow is introduced in the horizontal direction of the ablation point in an axial range of 2 cm. Nanocrystal Si films are deposited on glass or single crystalline (111) Si substrates placed at a distance of 1 cm below the nozzle. Then the same device is used to prepare the ranocrystal Si films at a pressure of 0.08 Pa with gas flow being, respectively, 0, 2.5, 5, 7.5, 10 sccm. The morphologies and microstructurs of the samples are characterized by atomic force microscopy (AFM), X-ray diffraction (XRD) and Raman scattering. The results show that the Si nanocrystal threshold pressure is 0.1 Pa without gasflow, and 0.05 Pa with gasflow. The size of Si nanocrystal decreases as the gasflow increases.

Keywords: pulsed laser ablation, Si nanocrystal, size, gas flow

PACS: 52.38.Mf, 61.46.Hk

DOI: 10.7498/aps.62.025204

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No: 2011CB612305), the Research Project of Colleges and University of Hebei Province (Grant No. Q2012084), and the Natural Science Foundation of Hebei Province (Grant Nos: E2011201134, E2012201035).

[†] Corresponding author. E-mail: hdwangyl@hbu.edu.cn